

株式会社メモおよびその他のIR情報

株主メモ(株式のご案内)

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで	株主名簿管理人	大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友信託銀行株式会社
株主確定基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 ※期末配当のみとさせていただきます。	同事務取扱場所	東京都中央区八重洲2丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 (郵便物送付先) 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先) 0120-176-417(フリーダイヤル)
定時株主総会	毎年6月開催	公告方法	当社のホームページに掲載します。ただし、事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告します。
単元株式数	100株		
証券コード	6258		
上場金融商品取引所	大阪証券取引所 JASDAQ市場		

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

その他のIR情報

平田機工株式会社ホームページ

<http://www.hirata.co.jp>


IR情報

<http://www.hirata.co.jp/ir/>


当社ホームページの個人投資家向けのページには、当社の事業内容、業績の推移、あゆみなど様々な情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

● IR情報に関するお問い合わせ先
平田機工株式会社 経営企画部 IR・広報室

TEL 096-272-5558

FAX 096-272-3618

E-mail hirata_ir@hirata.co.jp

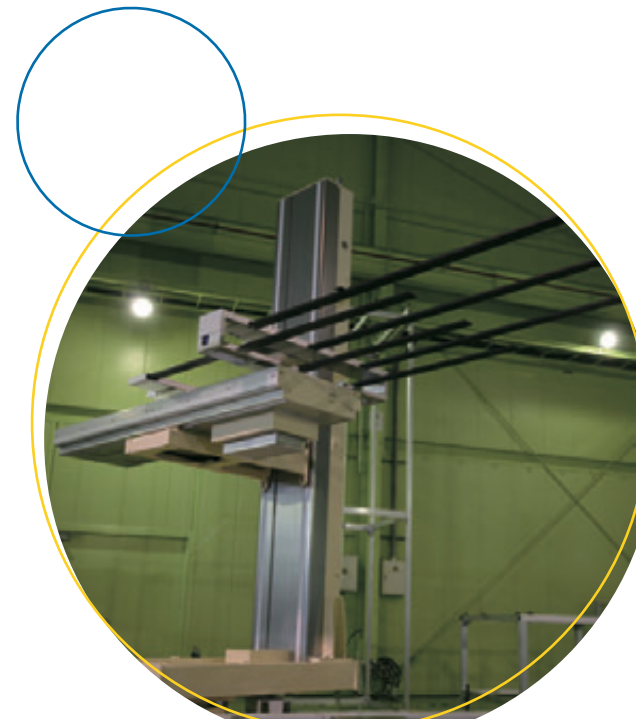
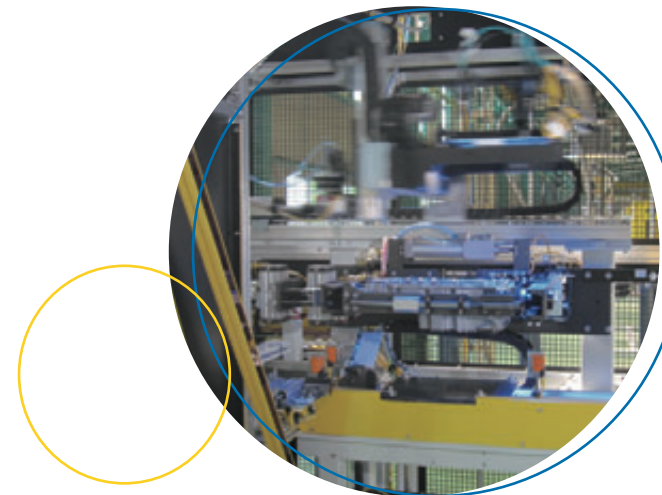
平田機工株式会社

本社
〒142-0041 東京都品川区戸越3丁目9-20
TEL.03-3786-1226 FAX.03-3786-1264

熊本本部
〒861-0198 熊本県熊本市植木町一木111
TEL.096-272-0555 FAX.096-272-7901

第61期 第2四半期 HIRATA REPORT

平成23年4月1日～平成23年9月30日


平田機工株式会社



代表取締役会長
平田 耕也

代表取締役社長
平田 雄一郎

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。第61期第2四半期累計期間(平成23年4月1日～平成23年9月30日)の事業概況を以下の通り、ご報告させていただきます。

当期間の世界経済は、緩やかな回復は継続したものの欧州でのギリシャをはじめとする財政問題、米国での失業率の高止まりや個人消費の伸び悩みに加え、これまで世界経済を牽引してきた新興国については高い成長率で推移していましたが、物価上昇や段階的な金融の引き締め政策などの実施により景気回復のペースは鈍化しました。

このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、円高進行や受注価格の低下など厳しい状況で推移することが予測される中、ローコストデザインによる原価低減や生産負荷調整による生産効率の向上などの取り組みにより、当期間の連結売上高は260億43百万円(前年同期比75.7%増)となりました。

事業別分野では、自動車分野において、北米の自動車メーカー向けなどの売上により大幅増収となり、FPD分野では、前期より受注しておりました中国の液晶メーカー向けの搬送装置を予定どおり売上げ増収、半導体分野でも、大型製造受託案件の売上が大きく貢献し、増収となりました。物流機器および家電関連分野においては、タイヤ業界向けの設備の売上が低調に推移しました結果、減収となりました。

利益面では、売上高の増加などにより、営業利益は9億93百万円(前年同期比625.0%増)、経常利益は9億45百万円(前年同期は54百万円の経常利益)、四半期純利益は3億91百万円(前年同期比1.7%減)となりました。

通期業績の見込みについて

当社は、平成23年11月10日に当第2四半期連結累計期間業績予想と実績値との差異に関するお知らせを発表しました。売上高は、当社および海外関係会社の売上予定案件の一部が下期にずれこんだことや国内関係会社の一部で売上が低迷したことなどから予想を下回りました。これに伴い、利益も予想を下回ったものの、黒字を確保することができました。

当期の見通しにつきましては、欧州での財政問題やドル不安、急激な円高とその定着化などにより、国内設備投資の低迷は続く予想され、国内企業の海外への

工場移転は加速すると思われます。

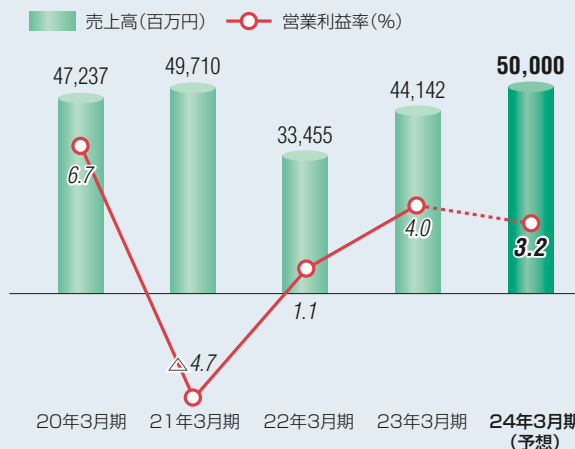
このような中、当社グループにおきましては、引き続き事業環境の変化に伴う取り組みを行っていくとともに、成長事業へのシフトやグローバルな営業活動の強化、そして当社の既存事業に独自の付加価値をプラスすることにより、事業の持続性を高めてまいります。

今後とも今まで培ってきた変化力を武器に、新しいモノ造りを考えてまいります。株主・投資家の皆様におかれましては、一層のご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■平成24年3月期 第2四半期
累計実績と通期業績予想(連結)

	第2四半期 累計実績	通期業績予想
売上高	260億円	500億円
営業利益	9.9億円	16億円
経常利益	9.4億円	14億円
四半期(当期)純利益	3.9億円	8億円
1株あたり四半期(当期)純利益	37.28円	76.14円
1株あたり配当金	0.00円	15.00円

■連結売上高・営業利益率推移



新型FOUPオープナおよびウェーハ搬送ロボットを開発

(2011年9月)

半導体製造装置分野において300mmウェーハに対応した業界最高水準となる高性能FOUPオープナと、
新型ウェーハ搬送ロボットを開発いたしました。

今回リリースしたFOUPオープナとウェーハ搬送ロボットは、ICチップやLSI(大規模集積回路)などの半導体製品をつくる過程において、主に原材料となるウェーハの搬送に使用される製品です。高性能の新製品を市場に投入することにより、お客さまのさらなるご期待に応え、半導体関連設備の売上増につなげてまいります。

FOUPオープナ



FOUP(収納容器)からウェーハを出し入れする際に、FOUPのフタの開閉を行います。

今回の開発により、業界トップクラスの高速動作、清浄空間の確保による線幅22nm(ナノメートル)のスーパークリーン対応、短時間での簡単な据付などを実現しました。

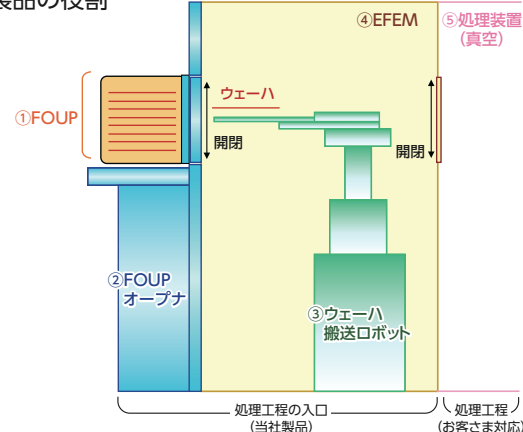
ウェーハ搬送ロボット



ウェーハをクリーン環境にて搬送するロボットです(FOUPから取り出し、プロセス処理装置への搬送にも使用されています)。

新たに、速度向上となめらかな連続動作、各軸構成の豊富なバリエーション、自社独自開発の制振制御搭載による振動防止などを実現しました。

製品の役割



1. ウェーハは、清浄空間に保たれた**FOUPと呼ばれる容器①**に収納され、各処理工程の入口まで搬送されます。
2. 搬送された容器を、各処理工程の前方にある**FOUPオープナ②**が開閉します。
3. **ウェーハ搬送ロボット③**が、容器内からウェーハを1枚ずつ取り出します。
4. ウェーハは、FOUPオープナとウェーハ搬送ロボットとこれらを組み合わせた装置である**EFEM④(Equipment Front End Module)**後方の開口部より、**処理装置⑤**へと搬送されます。
5. 搬送されたウェーハは、処理装置で回路焼き付けやカッティング、光剤塗布などの処理が行われます。

熊本工場に新棟を増設、Hirata最大の五面加工機を導入

(2011年9月)

現有の五面加工機より1.5倍の大きさの部材が加工できる、五面加工機を導入いたしました。



増設した棟

当社は、2011年8月、熊本工場敷地内に新しく工場棟を増設しました。増設した棟には、当社では最大となる五面加工機を導入し、9月1日から稼働を開始しました。五面加工機は、上面、両側面、両端面の5方向から高精度一体加工ができる工作機械で、各事業部門の製品に必要な部材の切削や穴加工に使用しています。

Hirataが保有する大型五面加工機

Hirataは、世界の生産設備メーカーに例をみない最新鋭の大型五面加工機を多数保有しており、当社の製品を構成する部品加工の大部分を自社にて内製できます。これにより低コストと短納期を実現し、Hirataのモノ造り力へとつなげています。

新しい五面加工機の導入により、現有の五面加工機に比べ1.5倍の大きさの部材が加工できるようになり、生産能力が拡大します。また、大型の次世代真空チャンバーへの対応も可能となります。Hirataはこれらの五面加工機を活用し、さらなる「大型、高精度、短納期」の内製能力拡大を目指し、モノ造り力を高めてまいります。



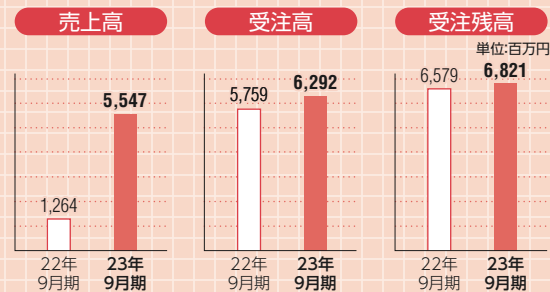
現有の五面加工機(一部)



9月に新しく導入した五面加工機

自動車関連生産設備事業

エンジン、トランスミッションなどの自動車の駆動系主要部品をはじめ、制御用電子機器、車載用電子部品などの組立設備の製造・販売



第61期 第2四半期実績

北米完成車メーカー向けや国内自動車部品メーカー向けなどの売上が堅調に推移した結果、売上高は55億47百万円(前年同期比338.8%増)となり、大幅に増収しました。円高やタイの洪水の影響が懸念されますが、日系メーカーも震災復興に伴い回復基調にあり、北米メーカーにおいては今後も設備投資が続く見通しであり、引き続き安定した受注確保に向けた営業体制の強化に努めていきます。



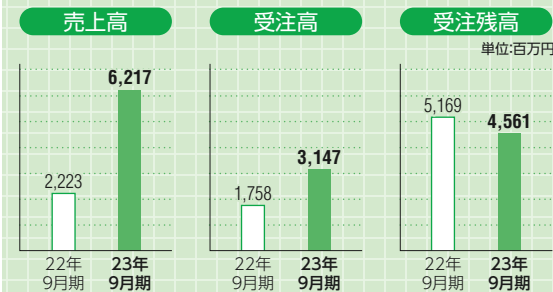
エンジン組立ライン



真空リフロー炉

FPD 関連生産設備事業

液晶・PDP(プラズマ・ディスプレイ・パネル)のもととなるガラス基板を搬送するシステム、ガラス基板に感光剤を塗布する装置の製造・販売



第61期 第2四半期実績

国内メーカーからの受注が堅調に推移したことに加え、塗布装置(ヘッドコーター)や前期より受注しておりました中国液晶メーカー向けの搬送装置などを予定どおり売上げ、売上高は62億17百万円(前年同期比179.6%増)となり、受注高につきましても増加となりました。



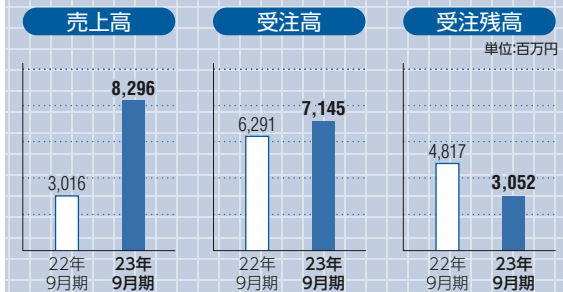
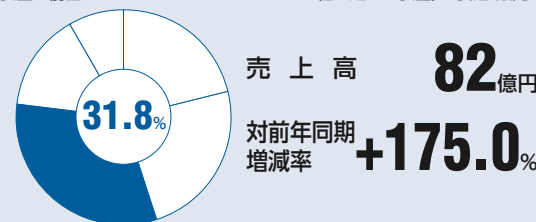
第5~6世代ガラス基板搬送ロボット



ソーラーモジュール組立装置

半導体関連生産設備事業

ロードポート、ウェーハ搬送ロボット、EFEM(ウェーハの処理を行うプロセス装置の前面にあり、ロードポートやロボットを組み込んだ装置)の製造・販売



第61期 第2四半期実績

ウェーハハンドリング装置を中心とした半導体分野においては、半導体市場の回復に加え、大型製造受託案件が大きく貢献した結果、売上高は82億96百万円(前年同期比175.0%増)の増収となりました。受注環境は必ずしも良好とは言えませんが、高性能の新商品の市場投入により半導体機器のさらなる受注拡大を図ります。



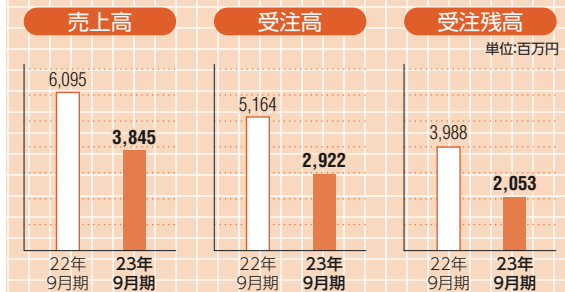
EFEM



ウェーハ搬送ロボット

物流機器および家電関連生産設備事業

家電関連分野では、薄型テレビ、冷蔵庫などの自動組立設備、タイヤ関連分野では、タイヤ搬送機、タイヤ仕上げ機などを製造・販売



第61期 第2四半期実績

物流機器および家電関連生産設備事業においては、家電業界向け設備およびタイヤ業界向けの設備の売上が低調に推移し、売上高は38億45百万円(前年同期比36.9%減)となりました。タイヤ関連は、国内での震災による低迷を脱し回復基調にあり、家電関連は、引き続き新興国を中心とした需要が増加すると見込んでいます。



自動倉庫



精密機器自動組立設備

連結財務諸表(要約)

■ 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	前第2四半期 連結会計期間末 (22.9.30)	当第2四半期 連結会計期間末 (23.9.30)	前連結会計 年度末に係る要約 連結貸借対照表 (23.3.31)
【資産の部】			
流動資産	31,959	39,779	40,969
現金及び預金	7,487	5,668	7,924
受取手形及び売掛金	16,005	25,590	25,727
商品及び製品	267	353	318
仕掛品	5,659	5,124	3,865
原材料及び貯蔵品	383	401	302
繰延税金資産	1,591	1,817	2,036
その他	679	868	840
貸倒引当金	△ 114	△ 44	△ 45
固定資産	20,292	19,258	19,569
有形固定資産	15,849	15,735	15,805
建物及び構築物(純額)	4,650	4,623	4,626
土地	9,796	9,797	9,790
その他	1,402	1,314	1,389
無形固定資産	368	344	367
投資その他の資産	4,074	3,178	3,395
資産合計	52,252	59,038	60,538

ポイント

1 現金及び預金

現金及び預金は、生産高の増加に伴い、運転資金需要が増加した結果、前期末比22億55百万円の減少となりました。

2 仕掛品

仕掛品は、海外子会社の仕掛増加などにより、前期末比12億58百万円の増加となりました。

3 支払手形及び買掛金

支払手形及び買掛金は、国内および中国メーカーとの取引の増加や買掛金の減少により、前期末比14億44百万円の減少となりました。

4 有利子負債

有利子負債は、運転資金需要の増加に伴い、短期借入を増やした一方、長期借入金は予定通りの返済が進んで減少し、前期末比2億73百万円の増加となりました。

(単位:百万円)

科目	前第2四半期 連結会計期間末 (22.9.30)	当第2四半期 連結会計期間末 (23.9.30)	前連結会計 年度末に係る要約 連結貸借対照表 (23.3.31)
【負債の部】			
流動負債	20,257	27,617	29,773
支払手形及び買掛金	6,718	11,985	13,429
短期借入金	4,896	6,897	6,104
一年以内返済予定の長期借入金	5,163	2,806	4,067
一年以内償還予定の社債	800	1,250	1,250
賞与引当金	80	129	69
その他	2,598	4,549	4,852
固定負債	15,347	13,993	13,493
社債	1,625	375	750
長期借入金	8,464	8,674	7,558
退職給付引当金	1,622	1,380	1,492
その他	3,635	3,563	3,692
負債合計	35,605	41,611	43,266
【純資産の部】			
株主資本	13,035	13,812	13,579
資本金	2,633	2,633	2,633
資本剰余金	2,322	2,322	2,322
利益剰余金	8,322	9,099	8,865
自己株式	△ 243	△ 243	△ 243
その他の包括利益累計額	3,371	3,408	3,425
少数株主持分	239	205	266
純資産合計	16,646	17,427	17,271
負債純資産合計	52,252	59,038	60,538

■ 四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	前第2四半期 連結累計期間 (自 22.4.1 至 22.9.30)	当第2四半期 連結累計期間 (自 23.4.1 至 23.9.30)	前期 (自 22.4.1 至 23.3.31)
売上高	14,822	26,043	44,142
売上原価	12,282	22,350	37,310
売上総利益	2,539	3,693	6,832
販売費及び一般管理費	2,402	2,700	5,050
営業利益	137	993	1,781
営業外収益	82	123	158
営業外費用	165	171	385
経常利益	54	945	1,554
特別利益	207	1	429
特別損失	6	41	446
税金等調整前 四半期(当期)純利益	254	906	1,537
法人税等	△ 116	575	599
少数株主利益	△ 27	△ 61	△ 3
四半期(当期)純利益	398	391	941

ポイント

5 売上高

FPD関連、半導体関連での売上増に加え、自動車分野において北米の自動車メーカー向けの案件を中心とした売上が大幅な増収となり、売上高は、前年同期比75.7%増の260億43百万円となりました。

6 営業利益

売上高の増加により営業利益は、前年同期比8億56百万円の増加となりました。

7 経常利益

経常利益は、売上高の増加および営業利益の増加などにより、前年同期比8億91百万円の増収となりました。

8 特別利益

特別利益は、固定資産の売却などにより、前年同期比2億5百万円の減少となりました。

9 営業活動による キャッシュフロー

営業活動によるキャッシュフローは、税金等調整前四半期純利益9億6百万円に対し、たな卸資産の増加13億79百万円、仕入債務の減少14億22百万円などにより、18億97百万円の支出となりました。

10 投資活動による キャッシュフロー

投資活動によるキャッシュフローは、投資有価証券の取得による支出1億9百万円、有形固定資産の取得による支出3億8百万円などにより、4億25百万円の支出となりました。

11 財務活動による キャッシュフロー

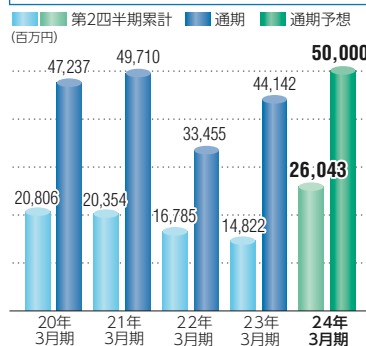
財務活動によるキャッシュフローは、長期借入れによる収入25億円、長期借入金の返済による支出26億44百万円、社債の償還による支出3億75百万円などにより、67百万円の収入となりました。

■ 連結キャッシュフロー計算書

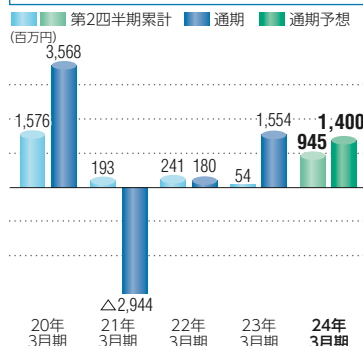
(単位:百万円)

科目	前第2四半期 連結累計期間 (自 22.4.1 至 22.9.30)	当第2四半期 連結累計期間 (自 23.4.1 至 23.9.30)	前期 (自 22.4.1 至 23.3.31)
営業活動による キャッシュフロー	△ 3,052	△ 1,897	△ 1,118
投資活動による キャッシュフロー	△ 46	△ 425	△ 301
財務活動による キャッシュフロー	529	67	△ 731
現金及び現金同等物に 係る換算差額	△ 65	0	△ 45
現金及び現金同等物の 増加額又は減少額(△)	△ 2,634	△ 2,255	△ 2,197
現金及び現金同等物の 期首残高	10,121	7,924	10,121
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	7,487	5,668	7,924

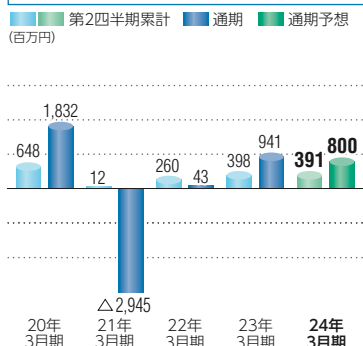
売上高



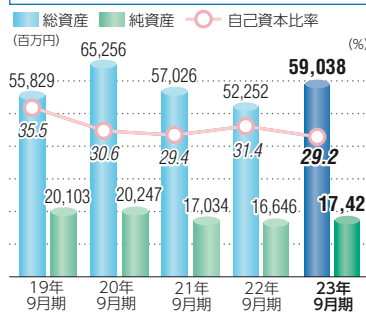
経常利益(損失)



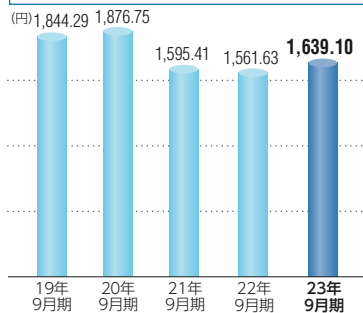
四半期(当期)純利益(損失)



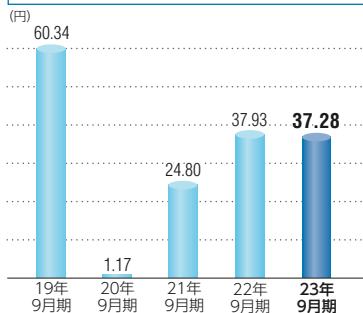
総資産/純資産



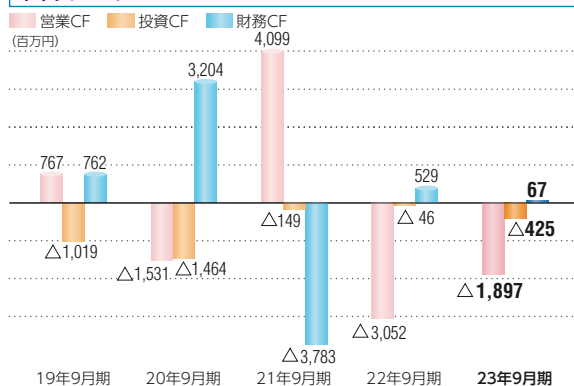
1株あたり純資産額



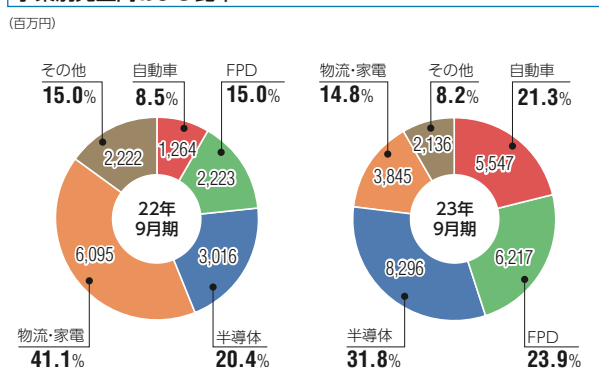
1株あたり四半期純利益



キャッシュ・フロー



事業別売上高および比率



会社概要 (平成23年9月30日現在)

会社名	平田機工株式会社	役員	代表取締役会長	平田 耕也	執行役員	堤 春生
会社設立	1951年12月29日		代表取締役社長	平田雄一郎	執行役員	藤原 五男
資本金	2,633百万円		取締役副社長執行役員	橘 勝義	執行役員	藤本 勝
従業員数	1,854名(連結 平成23年9月30日現在)		取締役執行役員	坂本 広徳	執行役員	平賀 靖英
業務内容	各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売		取締役執行役員	松永 盛文	執行役員	大田 謙次
本社所在地	東京都品川区戸越3丁目9番20号		取締役執行役員	田中 敏治		
			取締役	平田 宏之		
			常勤監査役	小川 克真		
			監査役	村田 邦夫		
			監査役	山田 昭		
			監査役	中村 洋一		

株式の状況 (平成23年9月30日現在)

- 発行可能株式総数 37,000,000 株
- 発行済株式総数 10,756,090 株
- 株主数 2,579 名

●所有者別株式分布状況

●大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
平田 耕也	994,462	9.25
平田機工社員持株会	839,310	7.80
平田 紀生	575,162	5.35
SMC株式会社	500,000	4.65
平田 宏之	464,972	4.32
平田 満	457,629	4.25
株式会社肥後銀行	456,000	4.24
平田 雄一郎	402,200	3.74
平田 滋夫	363,044	3.38
有限会社コンパス	224,000	2.08

●所有株数別株式分布状況

上記のほか、当社が保有している自己株式が249,387株あります。